

09613105

-12-

ABSTRACT OF THE DISCLOSURE

A ceramic carrier member for an electronic component has at least two metallic contact surfaces which are electrically insulated from each other, and which are disposed on a common plane of the carrier member. Further
5 metallized surfaces are positioned on at least one plane of the carrier member which is not parallel to the common plane of the contact surfaces. The metallized surfaces are respectively electrically conductively connected to the contact surfaces. In a method for making an electronic component, an inductive component is disposed on an inside surface of this carrier, and
10 wires proceeding from the inductive component are conducted through channels between the contact surfaces and are electrically connected to one of the metallized surfaces.

PCT

WELTORGANISATION FÜR GEISTIGES EIGENTUM
Internationales Büro



INTERNATIONALE ANMELDUNG VERÖFFENTLICHT NACH DEM VERTRAG ÜBER DIE
INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM GEBIET DES PATENTWESENS (PCT)

(51) Internationale Patentklassifikation ⁶ :

H01F 27/29, 27/02

A1

(11) Internationale Veröffentlichungsnummer: WO 99/53508

(43) Internationales
Veröffentlichungsdatum:

21. Oktober 1999 (21.10.99)

(21) Internationales Aktenzeichen: PCT/DE99/01007

(22) Internationales Anmeldedatum: 1. April 1999 (01.04.99)

(30) Prioritätsdaten:
198 15 852.1 8. April 1998 (08.04.98) DE

(71) Anmelder (für alle Bestimmungsstaaten ausser US): VAC-
UUMSCHMELZE GMBH [DE/DE]; Grüner Weg 37,
D-63450 Hanau (DE).

(72) Erfinder; und

(75) Erfinder/Anmelder (nur für US): LABATZKE, Armin
[DE/DE]; Königsteiner Strasse 14 A, D-61476 Kronberg
(DE).

(74) Gemeinsamer Vertreter: VACUUMSCHMELZE GMBH;
Epping, Wilhelm, Postfach 22 13 17, D-80503 München
(DE).

(81) Bestimmungsstaaten: BR, CA, CN, ID, JP, KR, MX, RU, SG,
US, europäisches Patent (AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES,
FI, FR, GB, GR, IE, IT, LU, MC, NL, PT, SE).

Veröffentlicht

Mit internationalem Recherchenbericht.

*Vor Ablauf der für Änderungen der Ansprüche zugelassenen
Frist; Veröffentlichung wird wiederholt falls Änderungen
eintreffen.*

(54) Title: SUPPORT FOR ELECTRONIC COMPONENTS

(54) Bezeichnung: TRÄGERKÖRPER FÜR ELEKTRONISCHE BAUELEMENTE

(57) Abstract

The invention relates to a ceramic support for electronic components which presents at least two contact surfaces (2) which are electrically insulated in relation to each other. The contact surfaces are arranged on a common plane of the support. The invention is characterized in that other metallized surfaces (3) are positioned on at least one plane of the support which is not parallel to the common plane of the contact surfaces (2). Each metallized surface is connected in a conductive manner to one of the contact surfaces (2). The invention also relates to the use of the support for inductive components and to a method for producing such a component.

(57) Zusammenfassung

Die Erfindung betrifft einen Trägerkörper für elektronische Bauelemente, wobei der Trägerkörper ein keramisches Bauelement mit mindestens zwei voneinander elektrisch isolierten Kontaktflächen (2), wobei die Kontaktflächen auf einer gemeinsamen Ebene des Trägerkörpers angeordnet sind, welcher dadurch gekennzeichnet ist, dass sich auf mindestens einer Fläche des Trägerkörpers, welche nicht parallel zur gemeinsamen Ebene der Kontaktflächen (2) verläuft, weitere metallisierte Oberflächen (3) befinden, wobei jeweils eine metallisierte Oberfläche mit einer der Kontaktflächen (2) leitfähig verbunden ist und die Verwendung dieses Trägerkörpers für induktive Bauelemente. Ferner ist ein Verfahren zur Herstellung dieses Bauelements beschrieben.

